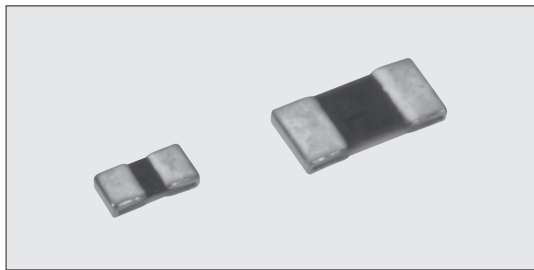
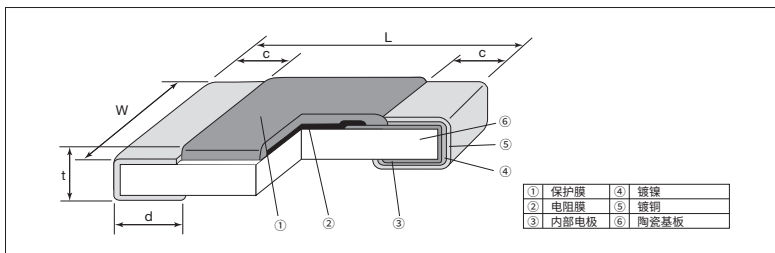


XR73B · XR73H · XR73Z ■ 基板内置用片式电阻器



外观颜色：黑色

■ 结构图



■ 特点

- 由于是低背型(高度0.13~0.14mm) (typ.)，因此可内置于多层接线基板的层中间。
- 由于采用Cu电极，因此可进行Cu导通孔连接。

■ 用途

- 通信模块、半导体封装用基板。
- 智能手机、平板电脑、笔记本PC、智能可穿戴式设备等。

■ 参考标准

IEC 60115-8
JIS C 5201-8
EIAJ RC-2134A

■ 外形尺寸

型号 (mm/inch Size Code)	尺寸 (mm)					重量 (g) (1000pcs)
	L	W	c	d	t	
1H (0603/0201)	0.6±0.03	0.3±0.03	0.23±0.03	0.23±0.03	0.13±0.02	0.11
1E (1005/0402)	1.0±0.05	0.5±0.05	0.28±0.05	0.28±0.05	0.14±0.03	0.26

■ 品名构成

实例

XR73H	1E	U	TWL	103	F
品种	额定功率	端子表面材质	二次加工	公称电阻值	阻值允许偏差
XR73B XR73H	1H : 0.063W 1E : 0.063W	U: Cu	TWL : 压纹编带 (2mm节距) TWA : 压纹编带 (1mm节距) BK : 散装	F: 4位 J: 3位	F: ±1% J: ±5%

XR73Z	1E	U	TWL
品种	额定电流	端子表面材质	二次加工
XR73Z	1H : 1A 1E : 1A	U: Cu	TWL : 压纹编带 (2mm节距) TWA : 压纹编带 (1mm节距) BK : 散装

欲知关于此产品含有的环境负荷物质详情(除EU-RoHS以外)，请与我们联系。
编带的TWA规格仅限1H。
编带细节参照卷末附录C。

■ 额定值

XR73B, XR73H

型号	额定功率*1	额定环境温度	电阻温度系数 (×10 ⁻⁶ /K)	电阻值范围(Ω)		最高使用电压	最高过载电压	二次加工和包装数量/卷 (pcs)	
				XR73H F: ±1% E24 · E96	XR73B J: ±5% E24			TWL	TWA
1H	0.063W	70°C	±200	10~1M	50V	100V	20,000	40,000	
			±400	1.0~9.1 ^{※2}					
			±100	10~1M					
1E	0.063W		±200	1.0~9.76 1.02M~10M	50V	100V	20,000	—	

使用温度范围：-55°C ~ +155°C

额定电压是√额定功率×公称电阻值所算出的值或表中最高使用电压两者中小的值为额定电压。

※1 为表面贴装状态下的额定值。

※2 XR73H1H (1Ω ≤ R ≤ 9.1Ω) 的公称电阻值为E-24。

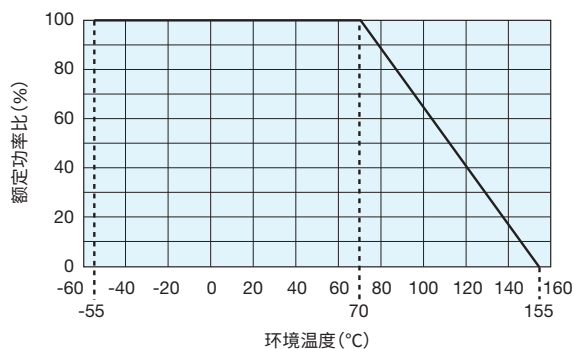
XR73Z

型号	电阻值	额定电流*	额定环境温度	最高过载电流	二次加工和包装数量/卷(pcs)	
					TWL	TWA
1H	50mΩ以下	1A	70°C	2A	20,000	40,000
1E		1A		2A	20,000	—

使用温度范围：-55°C ~ +155°C

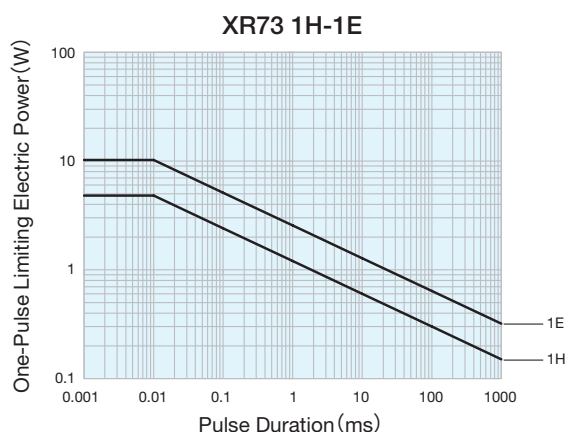
※为表面贴装状态下的额定值。

■功率降额曲线



在环境温度70°C以上使用时，应按照左图功率降额曲线，减小额定功率。

■单次脉冲极限功率曲线



可施加电压的上限为最高过载电压。
连续施加脉冲时的耐受性，请向我们咨询。
本数据为参考值，使用时请务必在实际机器上确认。

■性能*

试验项目	XR73H, XR73B		XR73Z		试验方法
	标准值	$\Delta R \pm (\% + 0.05\Omega)$	标准值		
	保证值	代表值	保证值	代表值	
电阻值	在规定的允许偏差内	—	50mΩ以下	15mΩ以下	25°C
电阻温度系数	在规定的允许偏差内	—	—	—	+25°C/-55°C、+25°C/+125°C
过载(短时间)	2	0.5	50mΩ以下	R ≤ 20mΩ: 1E R ≤ 40mΩ: 1H	额定电压(DC) × 2.5倍施加5秒钟 (1H为额定电压(DC)的2倍)
温度突变	1	0.5	100mΩ以下	R ≤ 20mΩ: 1E R ≤ 40mΩ: 1H	-55°C(30min.)/+125°C(30min.) 100 cycles
耐湿负荷	3	1.5	100mΩ以下	R ≤ 20mΩ: 1E R ≤ 40mΩ: 1H	40°C ± 2°C、90%~95%RH、1000h 1.5小时ON、0.5小时OFF的周期
在70°C时的耐久性	3	1	100mΩ以下	R ≤ 20mΩ: 1E R ≤ 40mΩ: 1H	70°C ± 2°C、1000h 1.5小时ON、0.5小时OFF的周期
高温放置	1	0.5	100mΩ以下	R ≤ 20mΩ: 1E R ≤ 40mΩ: 1H	+155°C、1000h

* 为表面贴装状态下的性能。

■使用注意事项

- 本产品在设计时以基板内置用、通过Cu电镀连接为前提。有关连接，请事先评估后再使用。
- 与通用品相比，由于是薄片型，因此请以正确的贴装条件(喷嘴形状、压入量、贴装速度等)使用。
- 散热状态根据基板的材质和接线布局等而发生变化，因此请根据内置状态进行评估后使用。